

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2007-278860

(P2007-278860A)

(43) 公開日 平成19年10月25日(2007.10.25)

(51) Int.CI.

| | | |
|---------------|--------------|------------------|
| GO 1 R | 1/073 | (2006.01) |
| HO 1 L | 21/66 | (2006.01) |
| GO 1 R | 31/26 | (2006.01) |

F 1

| | |
|--------|-------|
| GO 1 R | 1/073 |
| HO 1 L | 21/66 |
| HO 1 L | 21/66 |
| GO 1 R | 31/26 |

テーマコード(参考)

2 G 0 0 3

2 G O 1 1

4 M 1 0 6

J

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 18 頁)

(21) 出願番号

特願2006-105930(P2006-105930)

(22) 出願日

平成18年4月7日(2006.4.7)

(71) 出願人 000153018

株式会社日本マイクロニクス

東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目6番8号

(74) 代理人 100070024

弁理士 松永 宣行

(74) 代理人 100125081

弁理士 小合 宗一

(72) 発明者 濱田 和人

東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目6番8号

株式会社日本マイクロニクス内

(72) 発明者 秋庭 孝志

東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目6番8号

株式会社日本マイクロニクス内

最終頁に続く

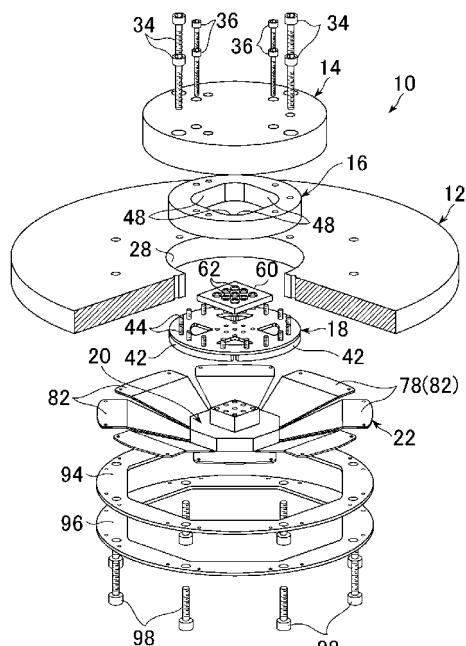
(54) 【発明の名称】電気的接続装置

(57) 【要約】

【課題】 被検査体の加熱又は冷却にともなう針先位置の変位を防止することにある。

【解決手段】 電気的接続装置は、貫通穴を中心にはする支持基板と、貫通穴内に位置するように又は貫通穴と対向するように支持基板に組み付けられた板ばねと、下方に向けられた取り付け面を有するプロックであって少なくとも取り付け面が支持基板より下方に突出した状態に板ばねの下側に取り付けられたプロックと、複数の接触子が配置された接触子領域と該接触子領域の周りの外側領域とを有する可撓性の回路基板であって少なくとも接触子領域がプロックの取り付け面に対向された状態に外側領域の一部において支持基板の下面に取り付けられた回路基板とを含む。板ばねは熱膨張率がステンレスのそれより小さい材料で形成されている。

【選択図】図1



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

上面及び下面を有すると共に、貫通穴を中央に有する支持基板と、前記貫通穴内に位置するように又は前記貫通穴と対向するように前記支持基板に組み付けられた板ばねと、

下方に向けられた取り付け面を有するブロックであって少なくとも前記取り付け面が前記支持基板より下方に突出した状態に前記板ばねの下側に取り付けられたブロックと、

複数の接触子が配置された接触子領域と該接触子領域の周りの外側領域とを有する可撓性の回路基板であって少なくとも前記接触子領域が前記ブロックの前記取り付け面に対向された状態に前記外側領域の一部において前記支持基板の下面に取り付けられた回路基板とを含み、

前記板ばねは熱膨張率がステンレスのそれより小さい材料で形成されている、電気的接続装置。

【請求項 2】

前記板ばねは、タンゲステン、モリブデン、それらの合金及びセラミックを含むグループから選択された材料で製作されている、請求項 1 に記載の電気的接続装置。

【請求項 3】

前記板ばねは、0.1 mm ~ 0.25 mm の厚さ寸法を有する、請求項 1 に記載の電気的接続装置。

【請求項 4】

前記接触子にオーバードライブを作用させたとき、前記板ばねは前記接触子の撓み量に対し 2 倍の撓み量を有する、請求項 1 に記載の電気的接続装置。

【請求項 5】

前記板ばねは、平坦な中央領域と、該中央領域から仮想円の周方向に間隔を置いてその仮想円の半径方向へ伸びる複数の板状のリム領域と、該リム領域の周りに一体的に続いている周縁領域とを有し、また周縁領域において支持基板に組み付けられており、

前記ブロックは、前記中央領域に取り付けられている、請求項 1 に記載の電気的接続装置。

【請求項 6】

前記ブロックは、前記取り付け面と該取り付け面の周りに続く中間面と該中間面の周りに続く斜面とにより形成された截頭多角錐形の下向き面を有し、

前記接触子領域及びこれの周りに続く前記外側領域の一部は、それぞれ、前記取り付け面及び前記中間面に對向され、前記外側領域の残りの一部は前記斜面に對向されている、請求項 5 に記載の電気的接続装置。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、集積回路や表示用基板のような平板状被検査体の通電試験に用いる電気的接続装置に関する。

【背景技術】**【0002】**

集積回路や表示用基板等の平板状被検査体は、プローブカードのような電気的接続装置を用いて通電試験をされる。通電試験の際、被検査体は、その電極に電気的接続装置の接触子を押圧され、その状態で通電される。

【0003】

この種の電気的接続装置の 1 つとして、可撓性電気絶縁性のシートに複数の配線を形成した FPC のような可撓性のシート状部材と、このシート状部材の各配線に接触子を半田付けした可撓性の回路基板を用いる技術がある（特許文献 1）。

【0004】

【特許文献 1】特開 2002 - 311049 号公報

10

20

30

40

50

【 0 0 0 5 】

上記従来技術においては、各接触子は、一端部において前記配線に結合された台座部と、該台座部の他端から前記配線の長手方向へ伸びるアーム部と、該アーム部の先端から台座部と反対の側に突出する針先部とを備える。アーム部と針先部とは、針先部の先端、すなわち針先が被検査体の電極に押圧されたとき、実質的にアーム部において弾性変形する本体部として作用する。

【 0 0 0 6 】

そのような接触子を用いる回路基板は、針先部を被検査体に向けることができるよう取り付け装置により配線基板のような支持基板に取り付けられて、電気的接続装置に組み立てられる。

10

【 0 0 0 7 】

取り付け装置は、配線基板の上面に配置された第1の補強板（板状部材）と、配線基板の中央に設けられた下向きの段部に位置するように前記段部に配置されたリング状第2の補強板（リング状部材）と、第2の補強板の下側にねじ止めされた板ばねと、少なくとも取り付け面を下側に有する台であって取り付け面が支持基板の下方に突出した状態に板ばねの下側にねじ止めされた台（ブロック）とを備えている。

【 0 0 0 8 】

第1の補強板は、第1の補強板及び配線基板を上下方向に貫通して第2の補強板に螺合された複数の取り付けねじにより、配線基板に取り付けられていると共に、第2の補強板を配線基板に取り付けている。

20

【 0 0 0 9 】

上記の回路基板は、接触子が配置された接触子領域において台の取り付け面に接着され、この接触子領域の周りの外周領域の最外周縁部において配線基板の下面にリング状の押え板及び複数の止めねじにより取り付けられている。

【 0 0 1 0 】

上記のような電気的接続装置は、プローバのような検査装置に取り付けられた後に、接触子の針先を被検査体の電極に押圧され、その状態で接触子に通電される。これにより、通電試験が実行される。

20

【 0 0 1 1 】

全ての針先により形成させる仮想的な針先面が配線基板又は被検査体に対し傾斜していると、針先が被検査体に押圧されることにより、板ばねが弾性変形する。これにより、接触子領域ひいては針先面が配線基板又は検査装置と平行に自動的に修正される。

30

【 0 0 1 2 】

しかし、従来の電気的接続装置では、これが被検査体を加熱又は冷却するバーイン試験に用いられることが多いにもかかわらず、加熱冷却にともなう板ばねの熱伸縮量が大きいステンレス板を板ばねとして用いている。

40

【 0 0 1 3 】

このため、従来の電気的接続装置では、被検査体の加熱又は冷却にともなって板ばねが不規則に熱伸縮し、被検査体の電極に対する接触子の針先位置が変位する。その結果、針先が損傷すると共に、被検査体の電極に対する針先の電気的接触状態が異なってしまう。

40

【 発明の開示 】**【 発明が解決しようとする課題 】****【 0 0 1 4 】**

本発明の目的は、被検査体の加熱又は冷却にともなう針先位置の変位を防止することにある。

【 課題を解決するための手段 】**【 0 0 1 5 】**

本発明に係る電気的接続装置は、上面及び下面を有すると共に、貫通穴を中央に有する支持基板と、前記貫通穴内に位置するよう又は前記貫通穴と対向するよう前記支持基板に組み付けられた板ばねと、下方に向けられた取り付け面を有するブロックであって少

50

なくとも前記取り付け面が前記支持基板より下方に突出した状態に前記板ばねの下側に取り付けられたプロックと、複数の接触子が配置された接触子領域と該接触子領域の周りの外側領域とを有する可撓性の回路基板であって少なくとも前記接触子領域が前記プロックの前記取り付け面に対向された状態に前記外側領域の一部において前記支持基板の下面に取り付けられた回路基板とを含む。前記板ばねは熱膨張率がステンレスのそれより小さい材料で形成されている。

【発明の効果】

【0016】

本発明によれば、熱膨張率がステンレスのそれより小さい材料製の板ばねを用いているから、被検査体の加熱又は冷却にともなう板ばねの熱伸縮、ひいては針先位置の変位が小さい。その結果、針先の損傷や、被検査体の電極に対する針先の接触不良が防止される。

【0017】

前記板ばねは、タングステン、モリブデン、それらの合金及びセラミックを含むグループから選択された材料で製作されていてもよい。

【0018】

前記板ばねは、0.1mm～0.25mmの厚さ寸法を有していてもよい。そのようにすれば、オーバードライブによる板ばねのたわみ量が最適な値となり、板ばねの不規則な撓みが防止される。

【0019】

前記接触子にオーバードライブを作用させたとき、前記板ばねは前記接触子の撓み量に対し2倍の撓み量を有していてもよい。そのようにすれば、オーバードライブによる板ばね及び接触子のたわみ量が最適な値となり、板ばね及び接触子の不規則な撓みが防止される。

【0020】

前記板ばねは、平坦な中央領域と、該中央領域から仮想円の周方向に間隔をおいてその仮想円の半径方向へ伸びる複数の板状のリム領域と、該リム領域の周りに一体的に続いている状の周縁領域とを有し、また周縁領域において支持基板に組み付けられており、前記プロックは前記中央領域に取り付けられていてもよい。そのようにすれば、オーバードライブが接触子に作用したときに、板ばねが均一に弾性変形する。その結果、板ばねの不規則な撓みが確実に防止される。

【0021】

前記プロックは、前記取り付け面と該取り付け面の周りに続く中間面と該中間面の周りに続く斜面とにより形成された截頭多角錐形の下向き面を有し、前記接触子領域及びこれの周りに続く前記外側領域の一部は、それぞれ、前記取り付け面及び前記中間面に対向され、前記外側領域の残りの一部は前記斜面に対向されていてもよい。

【発明を実施するための最良の形態】

【0022】

[用語について]

【0023】

本発明においては、図1において、左右方向をX方向又は左右方向といい、前後方向を前後方向又はY方向といい、上下方向を上下方向又はZ方向という。しかし、それらの方向は、被検査体を検査装置に配置する姿勢、すなわち検査装置に配置された被検査体の姿勢により異なる。

【0024】

したがって、上記の方向は、実際の検査装置に応じて、X方向及びY方向が、水平面、水平面に対し傾斜する傾斜面、及び水平面に垂直の垂直面のいずれかの面内となるように決定してもよいし、それらの面の組み合わせとなるように決定してもよい。

【実施例】

【0025】

電気的接続装置10は、矩形をした集積回路（図示せず）の通電試験にプローブカード

10

20

30

40

50

と同様に用いられる。集積回路は、複数の電極を有している。それらの電極は、図9に示す例では、左右方向（又は、前後方向）に間隔をおいて2列に配列されている。

【0026】

図1～図13を参照するに、電気的接続装置10は、円板状の支持基板12と、支持基板12の上面に取り付けられた板状部材14と、板状部材14の下側に配置された板状のリング状部材16と、リング状部材16の下側に配置された板ばね18と、板ばね18の下面に装着された台すなわちブロック20と、ブロック20の下側に配置されたフィルム状基板すなわち回路基板22と、ブロック20に取り付けられた複数の基準マーク部材24と、板状部材14をこれの厚さ方向に貫通して前記リング状部材16に当接する複数の調整ねじ26（図2及び図3参照）とを含む。

10

【0027】

支持基板12は、これの中央を厚さ方向（上下方向）に貫通する貫通穴28を有し、テスターに接続される複数のテスター・ランド30（図2参照）を上面の周縁部に有し、複数の接続ランド32（図5及び図13参照）を貫通穴28と外周縁との間の領域の下面に周方向に間隔をおいて有している。貫通穴28は、円形の平面形状を有する。

【0028】

支持基板12は、また、それぞれがテスター・ランド30と接続ランド32とを一対一の形に接続する複数の配線（導電路）を内部に有している。そのような支持板12は、ガラス入りエポキシ樹脂やセラミック材から製造された配線基板とすることができます。

20

【0029】

板状部材14は、貫通穴28より大きい円板状の形状を有しており、また板状部材14を貫通して支持基板12に螺合された複数のねじ部材34により、貫通穴28を閉塞する状態に、すなわち支持基板12と平行に支持基板12の上面に取り付けられている。

【0030】

板状部材14は、支持基板12の補強板として作用するように、ステンレスのような金属材料で製作されている。このため、板状部材14は、完全な板である必要はなく、後に説明する板ばね18のように、平坦な中央部と、この中央部から仮想円の周方向に間隔をおいてその仮想円の半径方向へ伸びる複数の延在部と、これらの延在部の先端に連結されて仮想円の周方向へ伸びる外周部とにより板状の形状を有するものであってもよい。

30

【0031】

図6に示すように、リング状部材16も、ステンレスのような金属材料、特に熱膨張率の小さい金属材料で貫通穴28の直径寸法よりやや小さい外径寸法を有する板状リングの形に形成されており、また支持基板12の貫通穴内に位置されている。

【0032】

リング状部材16は、板状部材14をこれの厚さ方向に貫通してリング状部材16に螺合された複数の取り付けねじ36により、支持基板12及び板状部材14と平行に板状部材14の下面に取り付けられている。

【0033】

図6に示すように、板ばね18は、平坦な中央領域38と、中央領域38から仮想円の周方向に間隔をおいてその仮想円の半径方向へ伸びる複数の板状のリム領域39と、リム領域39の周りに一体的に続くリング状の周縁領域40とを有している。

40

【0034】

中央領域38と板状のリム領域39とは、星印（*）状の形状を有している。リム領域39の数は、4つ、6つ、8つ等の適宜な値とすることができます。図示の例では、リム領域39の数は4つであり、したがって中央領域38とリム領域39とは中央領域38で交差する十字状の形状を有している。

【0035】

板ばね18は、熱膨張率がステンレスのそれより小さい、タンゲステン、モリブデン、それらの合金及びセラミック材料を含むグループから選択された材料で製作されている。

【0036】

50

板ばね 18 の厚さ寸法は、0.1 mm ~ 0.25 mm 程度とすることができます。板ばね 18 の厚さ寸法が、0.1 mm を超えると、板ばね自体の剛性が大きくなりすぎ、0.25 mm 未満であると、板ばね自体のばね性が小さくなりすぎる。その結果、板ばね 18 の厚さ寸法が上記範囲内であれば、後に説明するオーバードライブによる板ばね 18 のたわみ量が最適な値となり、板ばね 18 の不規則な撓みが防止される。

【0037】

板ばね 18 は、それぞれが弧状をした複数のばね押え 42 と、ばね押え 42 を下方から貫通してリング状部材 16 に螺合された複数のねじ部材 44 とにより、周縁領域 40 においてリング状部材 16 の下面に支持基板 12 と平行に組み付けられている。

【0038】

図示の例では、ばね押え 42 は、それらで板ばね 18 の周縁領域 40 に類似のリングを形成するように、組み合わされている。しかし、リング状をした単一のばね押えであってもよい。

【0039】

図 6 に示すように、リング状部材 16 及びばね押え 42 の内周面は、それぞれ、板ばね 18 のリム領域 38 と外周領域 40 との境界に対応する箇所を、板ばね 18 の外周の接線方向及び上下方向へ伸びる平面領域 46 及び 48 とされている。

【0040】

図 7 に示すように、ブロック 20 は、回路基板 22 を取り付ける取り付け面 50 と取り付け面 50 の周りに続く中間面 51 と中間面 51 の周りに続く複数の斜面 52 とにより形成された截頭多角錐形の下向き面を有する下部ブロック部 54 と、上端面を板ばね 18 への被取り付け面 56 とする角柱状の上部ブロック部 58 とを備える。

【0041】

図示の例では、取り付け面 50 と中間面 51 と被取り付け面 56 とは平行の面であり、また下部ブロック部 54 の下向き面は截頭八角錐形の形状を有している。

【0042】

ブロック 20 は、板ばね 18 の中央領域 38 を矩形の組み付け板 60 と上部ブロック部 58 とによりサンドイッチ状に挟んだ状態に、及び下部ブロック部 54 が支持基板 12 の下方へ突出した状態に、上部ブロック部 58 において複数のねじ部材 62 により板ばね 18 の中央領域 38 の下面に組み付けられている。ブロック 20 の取り付け面 50 は、試験すべき集積回路の形状に類似した矩形の形状を有している。

【0043】

図 11 及び図 12 に示すように、下部ブロック部 54 の下端部は、取り付け面 50 がこれの周りの中間面 51 よりわずかに下方に突出している。そのような下部ブロック部 54 の下端部は、取り付け面 50 に開口する凹所 64 と、凹所 64 の周りを伸びる下向きの溝 66 とが形成されている。

【0044】

図 8 ~ 図 13 に示すように、回路基板 22 は、ポリイミドのような電気絶縁性のシート 70 の内部に帯状をした複数の配線すなわち導電路 72 を形成し、各導電路 72 に接触子 74 を装着している。このため、回路基板 22 は可撓性を有する。シート 70 は、3 つのシート部材 70a, 70b 及び 70c で構成されている。

【0045】

回路基板 22 は、接触子 74 が配置された矩形の接触子領域 76 と、接触子領域 76 の周りの外側領域 78 とを有する。外側領域 78 は、接触子領域 76 の周りに一体的に続く中間領域 80 と、中間領域 80 の周りに間隔をおいて中間領域 80 から針先領域 76 を中心とする仮想円の半径方向へ伸びる複数の延在部 82 とを備える。

【0046】

各導電路 72 は、接触子 74 が配置された接触子領域 76 内から外側領域 78 を上記仮想円の半径方向外方へ伸びている。各導電路 72 の外側端部には、シート部材 70b 及び 70c を貫通して上方に突出する接続バンプ 84 (図 13 参照) 図示の例では、各導電路

7 2 は、銅、ニッケル、銅の三層構造とされている。

【0047】

図11及び図12に示すように、プレート86は、接触子領域76の平坦性を維持するように、接触子領域76に対応する箇所に埋め込まれている。これにより、接触子領域76は、プレート86の厚さと中間面51に対する取り付け面50の突出量との和に相当する分だけ、中間面51から下方に突出されている。プレート86は、セラミック板、ステンレス板等の適宜な材料で製作される。

【0048】

シート部材70a及び70bは導電路72を共同して挟んでおり、シート部材70b及び70cはプレート86を共同して包み込んでいる。

10

【0049】

上記のようなシート70、導電路72及びプレート86は、フォトリソグラフィー技術、電気メッキ技術、樹脂の塗布技術、電気鋳造技術等を利用して、シート部材70aの一方の面に複数の導電路72を形成し、次いでシート部材70bをシート部材70aの導電路72の側に形成し、プレート86をシート部材70bの接触子領域76に対応する箇所に配置し、シート部材70cをシート部材70bのプレートの側に形成することにより、製作することができる。

【0050】

各接触子74は、対応する導電路72に接合されてシート部材70aの下方へ突出する台座部88と、台座部88の下端に一体的に続く本体部90とを含む。

20

【0051】

台座部88は、対応する導電路72の接合部と同種の金属材料（例えば、銅）で形成された第1の座部88aと、第1の座部88aの下端に接合された第2の座部88bとを備える。

【0052】

第1の座部88aは、この後端面において対応する導電路72に接合されている。第2の座部88bは、本体部90と同じ金属材料（例えば、ニッケル）で本体部90と一体的に製作されている。

【0053】

本体部90は、第2の座部88bの下端から水平に伸びるアーム部90aと、アーム部90aの先端から下方に突出する針先90bとを備える。

30

【0054】

上記のような接触子74は、例えば、フォトリソグラフィー技術、電気メッキ技術、電気鋳造技術等を利用して、第1の座部88a、第2の座部88b、アーム部90a及び針先部90bを、その順番で又は逆の順番で順次形成することにより、製作することができる。

40

【0055】

上記のように製作された接触子74は、シート部材70aの一部を除去した後に、導電性接着剤により第1の座部88aの上端面において対応する導電路72に接合される。これにより、各接触子74は、本体部90がシート70から下方へ離間した状態に、シート70に片持ち梁状に支持される。

【0056】

しかし、シート70、導電路72及び接触子74を、フォトリソグラフィー技術、電気メッキ技術、樹脂の塗布技術、電気鋳造技術等を利用して、一貫して製作してもよい。これによつても、各接触子74はシート70に片持ち梁状に支持される。

【0057】

上記の場合、針先90b、アーム部90a、第2の座部88b、シート部材70a、第1の座部88a、導電路72、シート70b及びシート部材70cの順に製作することができる。プレート86は、シート部材70cを形成するに先立つてシート部材70bに配置すればよい。

50

【0058】

上記のように回路基板22を製作すれば、導電路72と第1の座部88a、第1の座部88aと第2の座部88b、第2の座部88bとアーム部90a、及びアーム部90aと針先90bのそれぞれの結合強度が大きくなる。

【0059】

また、第1の座部88aが導電路72の接合部と同種の金属材料であり、第2の座部88bが本体部90と同じ金属材料であると、第1の座部88aと導電路72との結合強度、及び第2の座部88bと本体部90との結合強度がより大きくなる。

【0060】

第1及び第2の座部88a及び88bの接合面は、図12に示すように、シート部材70a内とされている。これにより、両座部88a及び88bの接合面がシート部材70aにより包囲されるから、台座部88に曲げモーメントが作用しても、その曲げモーメントによる第1及び第2の座部88a及び88bの分離が防止される。10

【0061】

図11及び図12に示すように、回路基板22は、接触子領域76及び中間領域80がブロック20の取り付け面50に対向され、延在部82の一部が斜面52に対向された状態に、少なくとも接触子領域76において、凹所64に貯留されている接着剤92により取り付け面50に接着されている。

【0062】

接触子領域76及びその周囲の中間領域80は、それぞれ、ブロック20への接着時に取り付け面50及びその周りの中間面51に押圧される。これにより、凹所64内の余分な接着剤が接触子領域76の周囲の領域（中間領域80の少なくとも一部の領域）に押し出されるから、回路基板22は、接触子領域76の周囲の領域においても、取り付け面50の周りの領域（中間面51の少なくとも一部）に接着される。その結果、図12に示すように、回路基板22は、接触子領域76がその周りの箇所より下方に突出した状態に維持される。20

【0063】

上記のように接触子領域76及びその周りの領域が取り付け面50及びその周りの領域に接着されると、接触子領域76及びその周りの領域がブロック20に安定に支持されるから、接触子74が支持基板12に対し安定する。30

【0064】

回路基板22は、また、接続バンプ84が図13に示すように接続ランド32に押圧された状態に、シリコーンゴムのように弾性を有する板状のゴムリング94と、ステンレスのようにある程度の剛性を有する板状の押えリング96と、複数のねじ部材98とにより、支持基板12の下面に取り付けられている。

【0065】

支持基板12に対する回路基板22の位置決めは、回線基板12から下方に伸びて、回路基板22、ゴムリング94及び押えリング96を貫通して下方に突出する複数の位置決めピン100により行われる。各位置決めピン100は、支持基板12に安定に支持されている。40

【0066】

回路基板22が上記のようにブロック20及び支持基板12に装着された状態において、各接触子74は、その針先90bが被検査体の対応する電極と対向するよう整列されており、また導電路72、接続バンプ84、接続ランド32、支持基板12内の配線等を介して支持基板12のテスター・ランド30に電気的に接続されている。

【0067】

各基準マーク部材24は、下部ブロック54の斜面52から下方に突出するピン部材であり、また上部において下部ブロック54に安定に支持されている。図示の例では、三組の基準マーク部材24が設けられている。各組の基準マーク部材24は、接触子領域76及び中間領域80を間にして対向されている。

5020304050

【 0 0 6 8 】

各基準マーク部材 2 4 の下端面は取り付け面 5 0 と平行の面であり、また各基準マーク部材 2 4 の下端面の高さ位置は接触子 7 4 の高さ位置より上方に後退されている。

【 0 0 6 9 】

各基準マーク部材 2 4 の下部は、回路基板 2 2 の延在部 8 2 において、隣り合う導電路 7 2 の間を貫通して、回路基板 2 2 の下方に突出されている。これにより、延在部 8 2 における隣り合う導電路 7 2 の間隔が中間領域 8 0 のそれより広いから、基準マーク部材 2 4 が導電路 7 2 の形成位置に影響を及ぼさない。

【 0 0 7 0 】

図 9 に示すように、各基準マーク部材 2 4 は、基準マーク 1 0 2 を下端面に有している 10。各基準マーク 1 0 2 は、接触子領域 7 6 を間にて対向する基準マーク部材 2 4 の基準マーク 1 0 2 と共同して、電気的接続装置 1 0 における両基準マーク 1 0 2 の間に位置する針先 9 0 の位置を表す。

【 0 0 7 1 】

基準マーク 1 0 2 は、光学的特性が周囲と異なる。基準マーク 1 0 2 は、図示の例では丸印の中心であるが、ドット、十字状の交差部等、とすることができる。

【 0 0 7 2 】

各基準マーク 1 0 2 は、予めマーク層を基準マーク部材 2 4 の下面に電気メッキや塗料の塗布等の適宜な手法により形成しておき、電気的接続装置 1 0 が完成した後に、針先 9 0 の位置を測定し、その測定結果に応じてマーク層の対応する箇所をレーザ光により除去することにより、形成することができる。そのようにすれば、電気的接続装置 1 0 の組み立て精度に依存されることなく、基準マーク 1 0 2 を正確に形成することができる。 20

【 0 0 7 3 】

ロック 2 0 、基準マーク部材 2 4 、ばね押え 4 2 、組み付け板 6 0 、位置決めピン 1 0 0 は、適宜な材料、好ましくは電気絶縁性の金属材料で製作される。

【 0 0 7 4 】

上記のように電気的接続装置 1 0 に組み立てられた状態において、支持基板 1 2 に対する接触子領域 7 6 の平行度が調整される。

【 0 0 7 5 】

この平行度調整は、リング状部材 1 6 への取り付けねじ 3 6 のねじ込み量を小さくした状態で、接触子領域 7 6 が支持基板 1 2 と平行になるように板状部材 1 4 への調整ねじ 2 6 のねじ込み量を調整し、その後、調整ねじ 2 6 がリング状部材 1 6 の上面に当接した状態に、取り付けねじ 3 6 をリング状部材 1 6 にねじ込むことにより、行うことができる。このため、支持基板 1 2 に対する接触子領域 7 6 の平行度を容易に調整することができる。 30

【 0 0 7 6 】

接触子領域 7 6 は、これが取り付け面 5 0 に接着されているから、上記の平行度調整時に、支持基板 1 2 に対しロック 2 0 と共に確実に変位する。

【 0 0 7 7 】

電気的接続装置 1 0 は、接触子領域 7 6 が被検査体の配置領域の上方となり、かつ各接触子 7 4 の針先 9 0 b が被検査体の電極と対向する状態に、検査装置に組み付けられ、支持基板 1 2 のテスター・ランド 3 0 を通電試験用の電気回路に接続される。これにより、各接触子 7 4 は通電試験用の電気回路に電気的に接続される。 40

【 0 0 7 8 】

電気的接続装置 1 0 は、これが検査装置に装着された状態において、検査装置に対する接触子 7 4 の針先 9 0 b の位置決めのために基準マーク 1 0 2 を測定される。

【 0 0 7 9 】

この測定の際、基準マーク 1 0 2 が接触子 7 4 以外の基準マーク部材 2 4 の下端面に形成されているから、異物が針先 9 0 b に残存するか否かにかかわらず、及び基準マーク 1 0 2 の近傍の光学的特性の影響を受けることなく、針先位置を高精度にかつ確実に測定す 50

ることができる。

【0080】

基準マーク102は、下端面が接触子領域76を間にして離間した少なくとも一組の基準マーク部材24の基準マーク102を測定すればよい。これにより、検査装置の座標における接触子74の二次元位置を正確に測定することができる。

【0081】

しかし、下端面が接触子領域76を間にして離間した三組の基準マーク部材24の基準マーク102を測定すれば、検査装置の座標における接触子74の二次元位置をより正確に測定することができる。

【0082】

通電試験時、電気的接続装置10と被検査体とが相寄る方向に相対的に移動される。これにより、各接触子74がその針先90bを被検査体の対応する電極に押圧されて、オーバードライブが接触子74に作用する。

【0083】

各接触子74の針先90bが被検査体の電極に押圧されると、オーバードライブにより、片持ち梁状の接触子74がアーム部90aにおいてわずかに弧状に弾性変形すると共に、板ばね18が弾性変形する。

【0084】

電気的接続装置10は、オーバードライブが接触子74に作用したとき、以下のようないくつかの技術的メリットを奏する。

【0085】

回路基板22の接触子領域76、中間領域80、及び延在部82に一部が、それぞれ、ブロック20の取り付け面50、中間領域80、及び延在部82の一部に対向されており、しかも各基準マーク部材24の下端面の高さ位置が接触子74の高さ位置より上方とされているから、針先90bが被検査体の電極に押圧されたとき、基準マーク部材24が被検査体に接触しない。

【0086】

接触子74が電極に押圧されると、板ばね18は回路基板22の接触子74の配置領域である中央領域の反力体として作用する。その結果、板ばね18は、回路基板22及びブロック20によりわずかに弾性変形されて、接触子領域76がオーバードライブにより上方に平行に変位することを許す。これにより、電極への接触子74の押圧力が均一になる。

【0087】

ブロック20は回路基板22の接触子領域76の変形を板ばね18に確実に伝達し、貫通穴28は板ばね18がリング状部材16の側へ容易に弾性変形することを許す。これにより、板ばね18及び回路基板22の弾性変形が安定化し、各接触子74は電極により接触しやすくなる。

【0088】

オーバードライブが接触子74に作用したときの板ばね18の不規則な撓みは、ブロック20が板ばね18の星印状又は十字状の交差部に取り付けられていること、リング状部材16及びばね押え42の内周面が板ばね18の外周面の接線方向及び上下方向に伸びる平面領域46及び48を板ばね18の中央領域38と周縁領域40との境界部に対応する各箇所に有していること等により、確実に防止されて、電極への接触子74の押圧力がより均一になる。

【0089】

両座部88a, 88bの結合部がシート70内に位置しているから、すなわちその結合部がシート70の厚さ寸法内に位置しているから、台座部88に作用する曲げモーメントの一部がシート70に受けられて、結合部がシート70により保護される。その結果、導電路72と台座部88との結合力が大きいにもかかわらず、オーバードライブによるシート70からの接触子の分離が防止される。

【0090】

台座部88は、本体部90、特に接触子74の先端をシート70から大きく離間させている。このため、オーバードライブにより、本体部90がシート70に接触し難いし、シート70が被検査体に接触し難く、それらの結果接触子74が被検査体の電極に確実に接触する。

【0091】

熱膨張率がステンレスのそれより小さい材料製の板ばね18を用いると、被検査体の加熱又は冷却にともなう板ばね18の熱伸縮、ひいては針先位置の変位が小さい。その結果、針先の損傷や、被検査体の電極に対する針先の接触不良が防止される。

【0092】

板ばね18が0.1mm～0.25mmの厚さ寸法を有していると、オーバードライブによる板ばね18のたわみ量が最適な値となり、板ばね18の不規則な撓みがより確実に防止される。

【産業上の利用可能性】

【0093】

本発明は、上記実施例に限定されず、その趣旨を逸脱しない限り、種々に変更することができる。

【図面の簡単な説明】

【0094】

【図1】本発明に係る電気的接続装置の一実施例を示す分解斜視図である。

20

【図2】図1に示す電気的接続装置の平面図である。

【図3】図2における3-3線に沿って得た断面図である。

【図4】図1に示す電気的接続装置の底面図である。

【図5】図1に示す電気的接続装置において回路基板及び押え板を除去した状態の底面図である。

【図6】リング状部材、板ばね及びね押えの一実施例を示す分解斜視図である。

【図7】ブロックの一実施例を示す斜視図である。

【図8】回路基板をブロックに取り付けた状態を示す斜視図である。

【図9】回路基板の接触子領域及びその周囲を拡大して示す底面図である。

30

【図10】回路基板の一実施例を示す平面図である。

【図11】図9における11-11線に沿って得た断面図である。

【図12】回路基板の接触子領域及びその周囲の拡大断面図である。

【図13】支持基板への回路基板の取り付け状態を示す拡大断面図である。

【符号の説明】

【0095】

10 電気的接続装置

40

12 支持基板

14 板状部材

16 リング状部材

18 板ばね

20 ブロック

22 回路基板

24 基準マーク部材

26 調整ねじ

28 貫通穴

30 テスター・ランド

32 接続ランド

34 ねじ部材

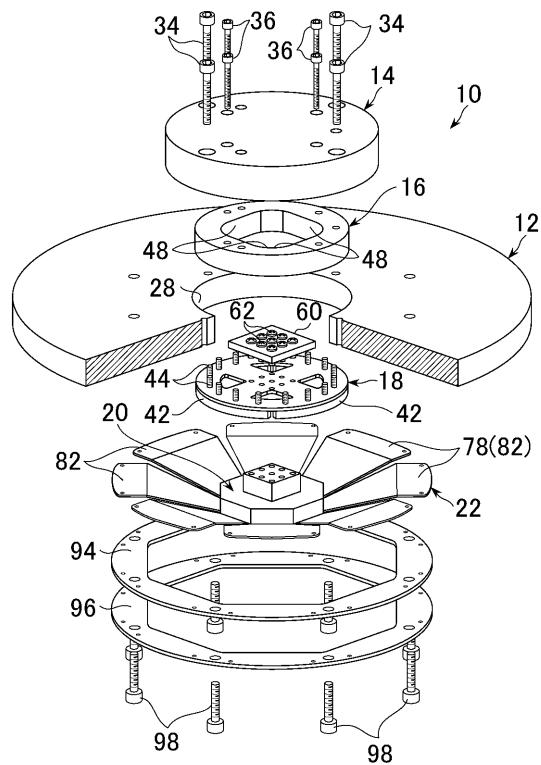
36 取り付けねじ

38 板ばねの中央領域

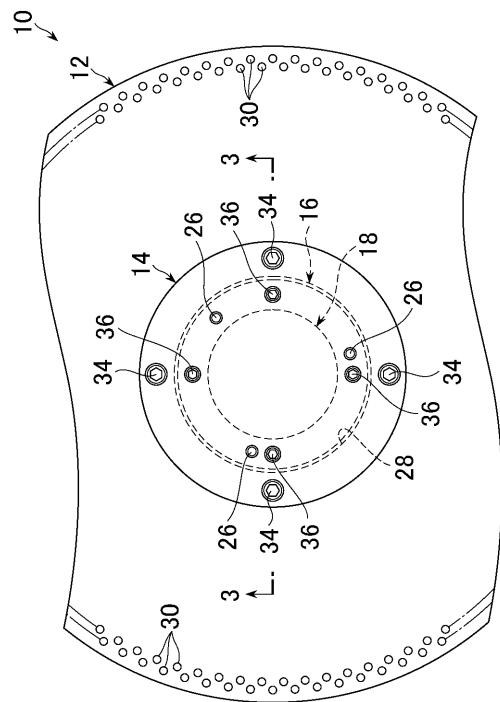
50

| | | |
|-----------------------|-------------|----|
| 4 0 | 板ばねの周縁領域 | |
| 3 9 | 板ばねのリム領域 | |
| 4 2 | ばね押え | |
| 4 4 | ねじ部材 | |
| 4 6 , 4 8 | 平面領域 | |
| 5 0 | ブロックの取り付け面 | |
| 5 1 | ブロックの中間面 | |
| 5 2 | ブロックの斜面 | |
| 5 4 | 下部ブロック部 | |
| 5 6 | ブロックの被取り付け面 | 10 |
| 5 8 | 上部ブロック部 | |
| 6 0 | 組み付け板 | |
| 6 2 | ねじ部材 | |
| 6 4 | ブロックの凹所 | |
| 6 6 | ブロックの溝 | |
| 7 0 | シート | |
| 7 0 a , 7 0 b , 7 0 c | シート部材 | |
| 7 2 | 導電路 | |
| 7 4 | 接触子 | |
| 7 6 | 回路基板の接触子領域 | 20 |
| 7 8 | 回路基板の外側領域 | |
| 8 0 | 回路基板の中間領域 | |
| 8 2 | 回路基板の延在部 | |
| 8 4 | 接続バンプ | |
| 8 6 | プレート | |
| 8 8 | 接触子の台座部 | |
| 8 8 a , 8 8 b | 第1及び第2の座部 | |
| 9 0 | 接触子の本体部 | |
| 9 0 a | アーム部 | |
| 9 0 b | 針先 | 30 |
| 9 2 | 接着剤 | |
| 9 4 | ゴムリング | |
| 9 6 | 押えリング | |
| 1 0 0 | 位置決めピン | |
| 1 0 2 | 基準マーク | |

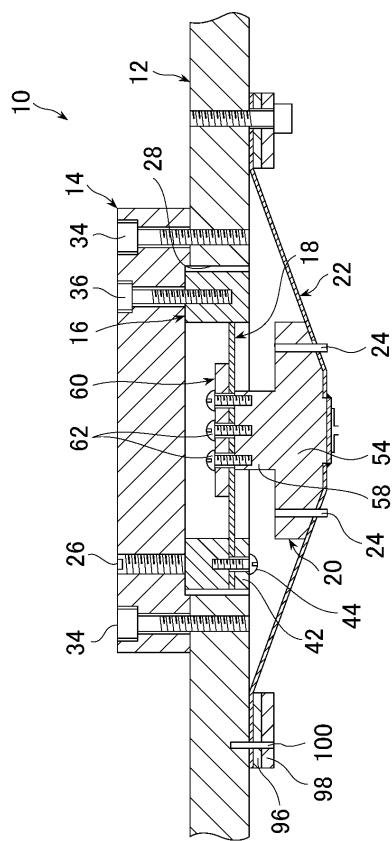
【 図 1 】



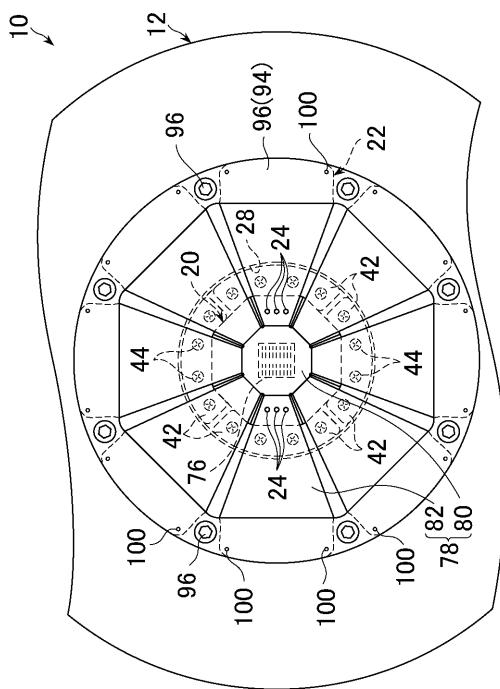
【 図 2 】



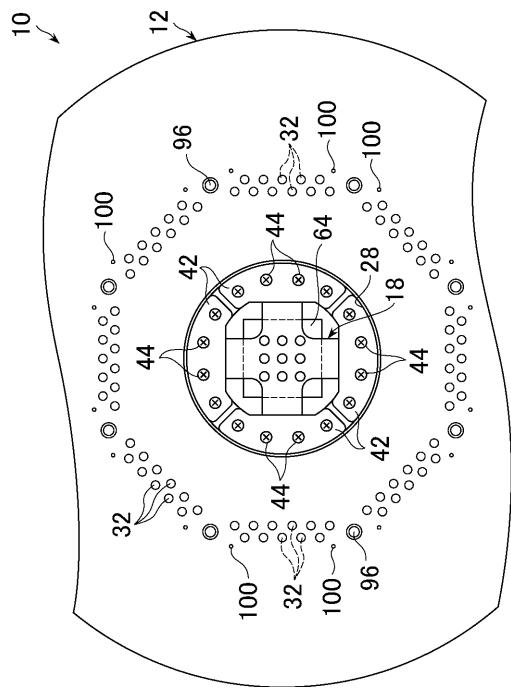
【図3】



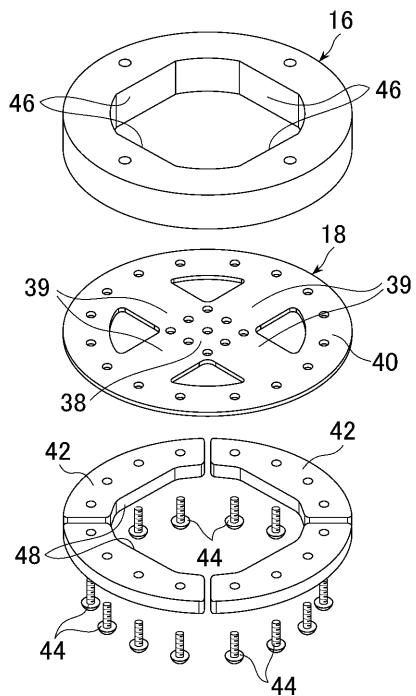
【 図 4 】



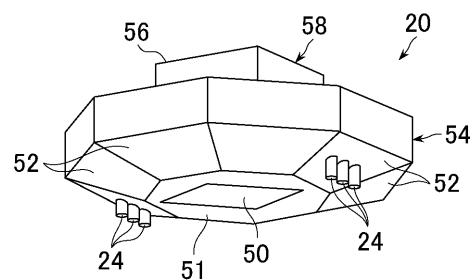
【図5】



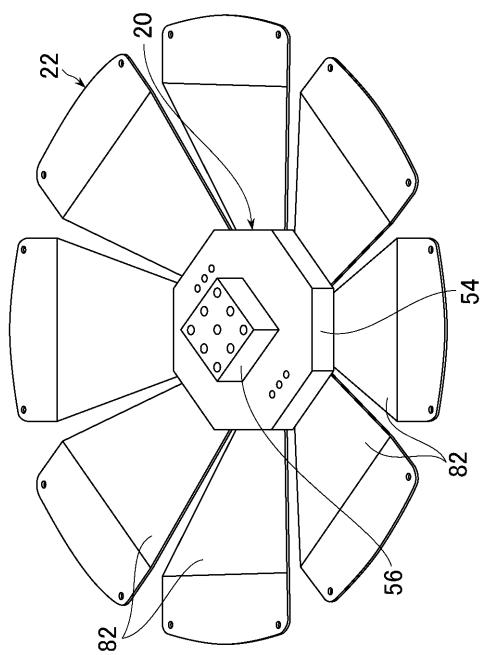
【図6】



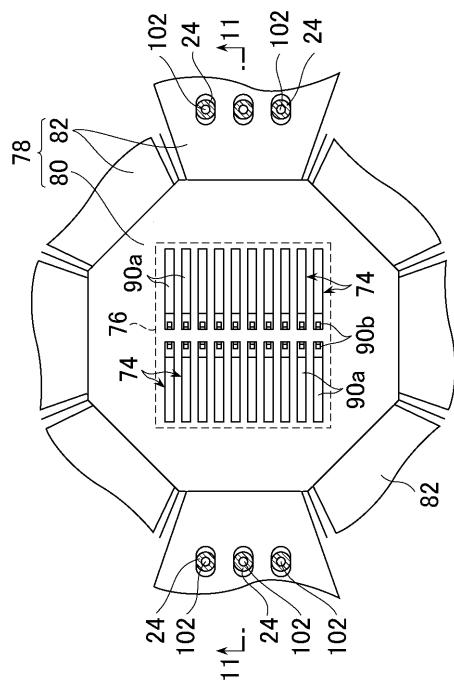
【図7】



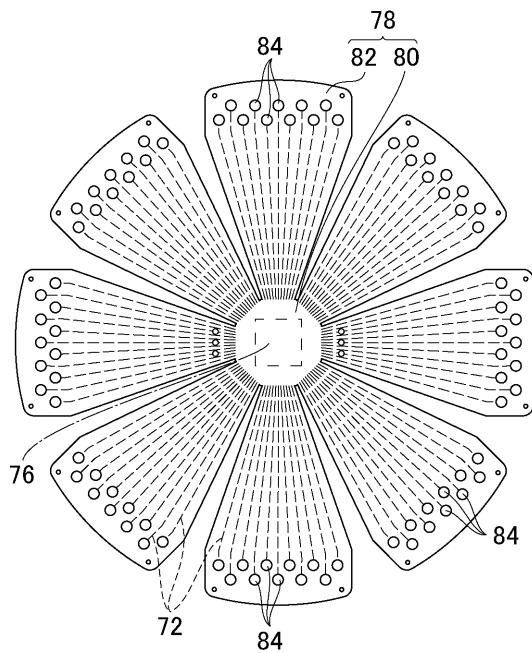
【図8】



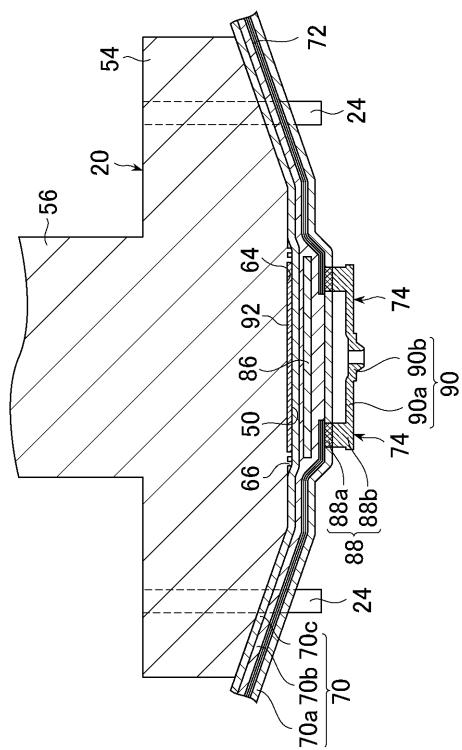
【図9】



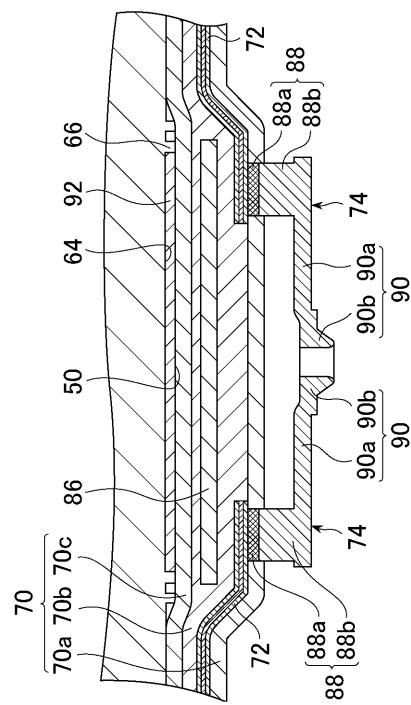
【図10】



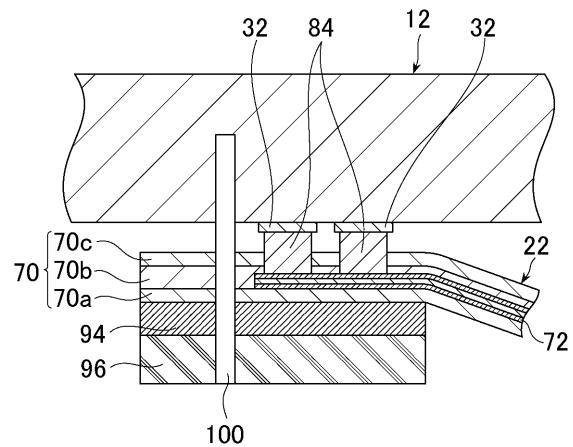
【図11】



【図12】



【図13】



【手続補正書】

【提出日】平成18年4月21日(2006.4.21)

【手続補正1】

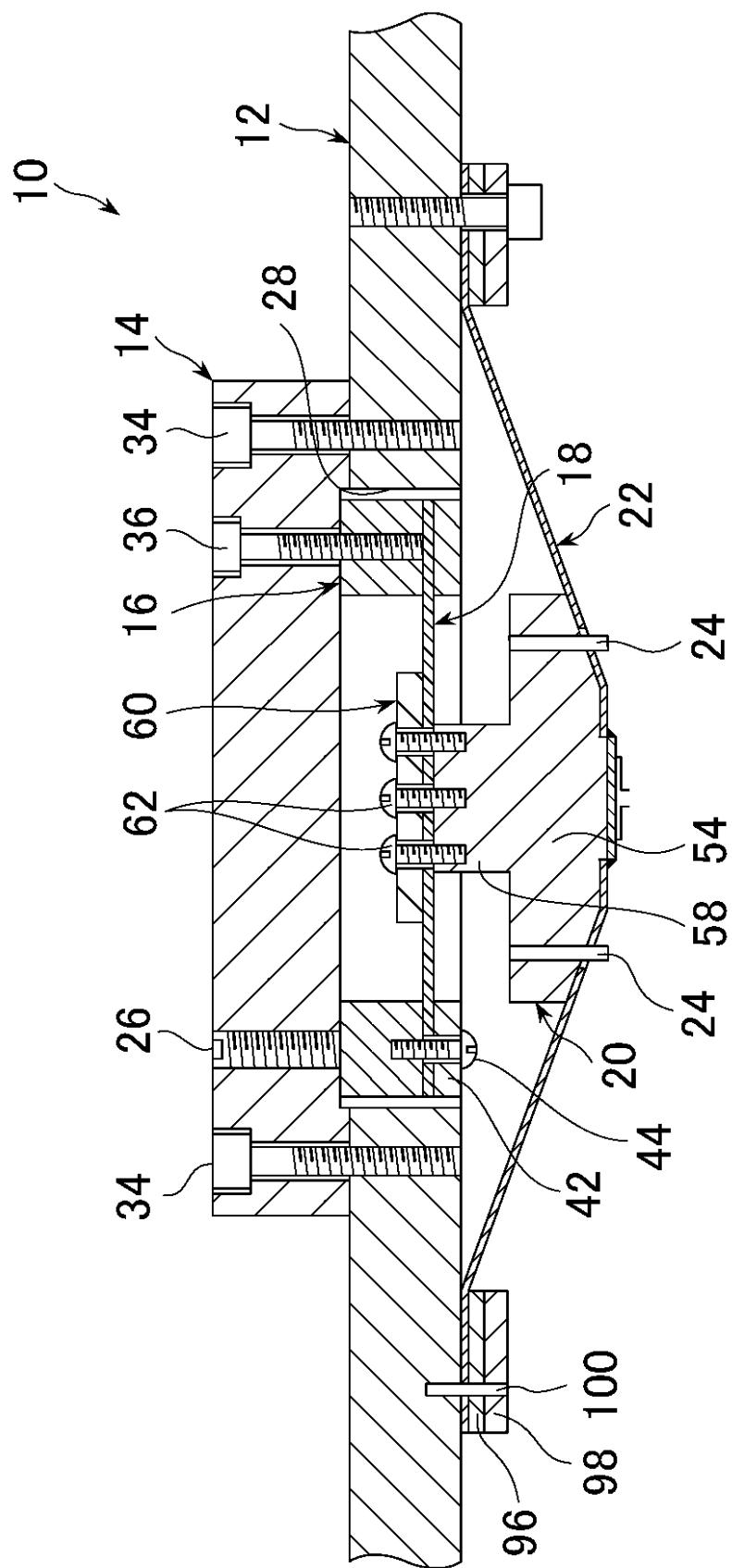
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図3】



フロントページの続き

(72)発明者 成田 聰

東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目6番8号 株式会社日本マイクロニクス内

F ター&ム(参考) 2G003 AA00 AA07 AG04 AG20

2G011 AB08 AC14 AE01 AE03 AF07

4M106 AA01 AA02 BA01 CA01 CA27 CA31 CA56 DD04 DD09